

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2024-015

杭州晶华微电子股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

为提高企业资金运营能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。

该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东大会审议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与合作银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种等将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人士在上述授信额度和期限内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2024年4月27日